

Descrição do Produto

- 100% novo e de alta qualidade!!
- O fluxo de resina é usado para facilitar a solda.
- Ele limpa e evita a oxidação do metal, o que permite à solda criar ligações mecânicas e elétricas fortes e duradouras.
- Também atua como umectante, aumentando o fluxo de solda e a eficiência do processo de solda.
- Perfeito para telefones celulares, placas de PC e outras sofisticadas soldas eletrônicas de fluxo no nível de chip.

Especificações

Produto: BST-706

Ponto de fusão: 138 °C

Peso: 500g

Ingredientes: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

SOLDER PASTE

Lead-free medium temperature



500g

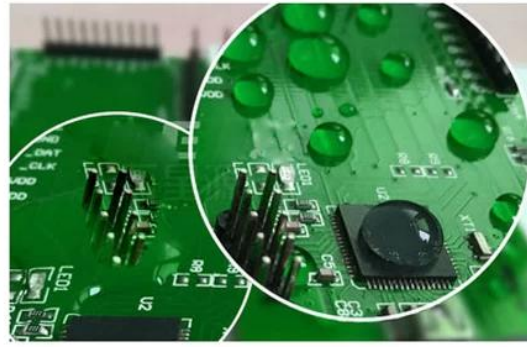
Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright

Product Usage

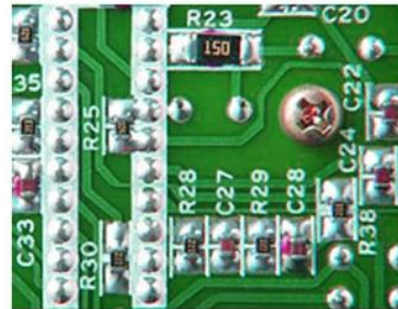
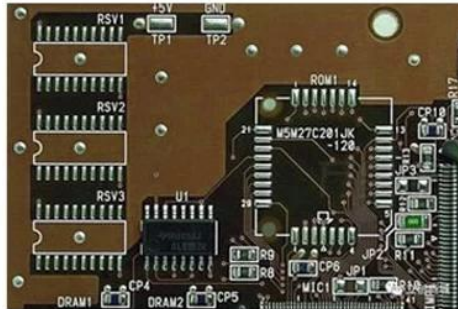


MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



Welding requirements for a wide range of products



TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE



63.0MM



75MM

52MM

